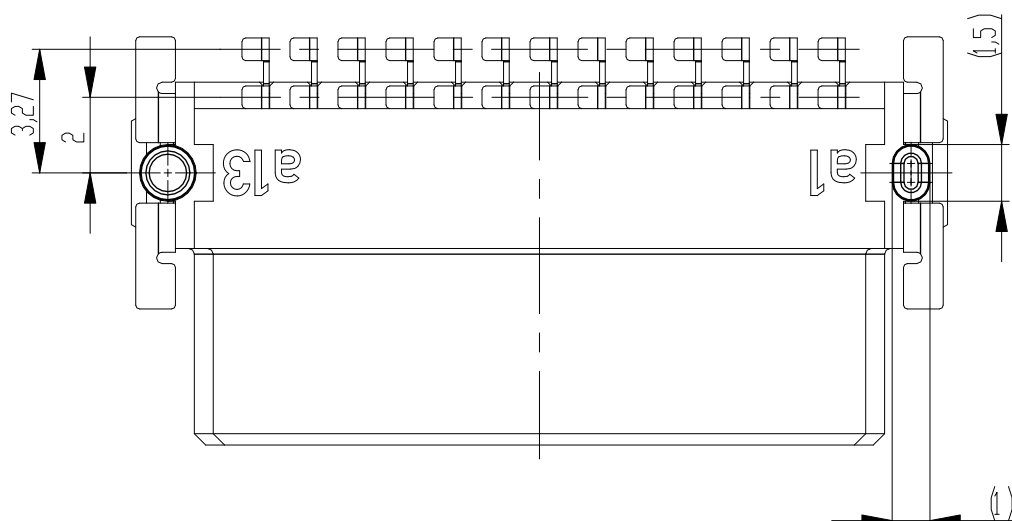
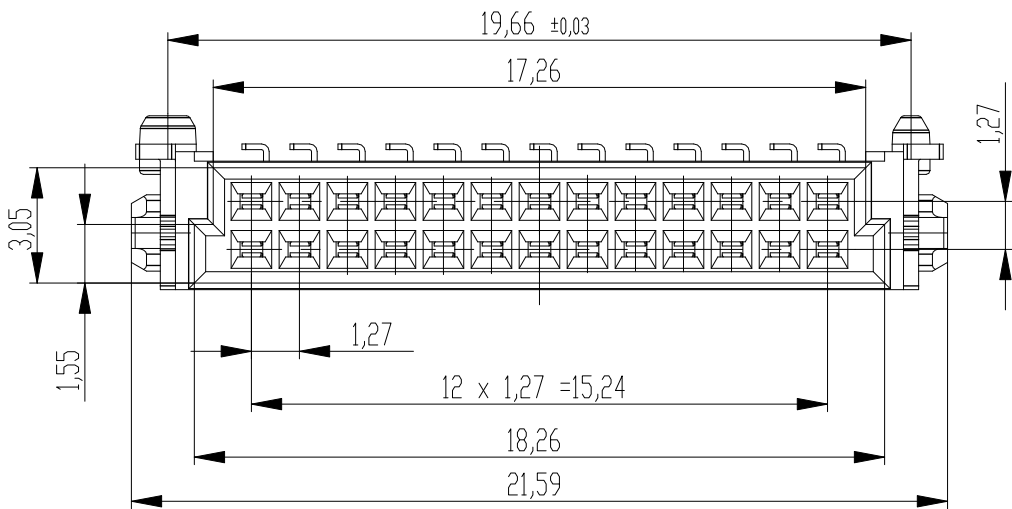
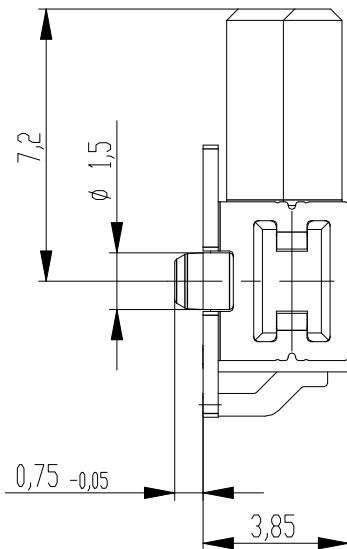
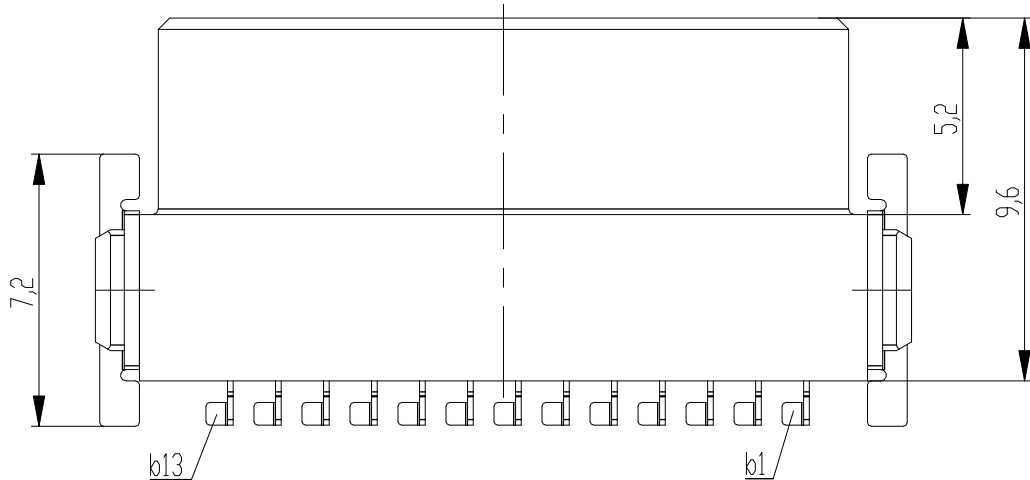
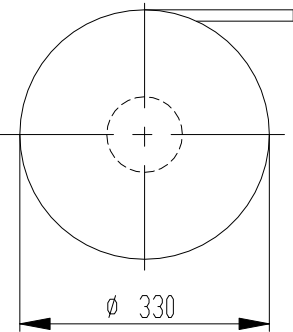
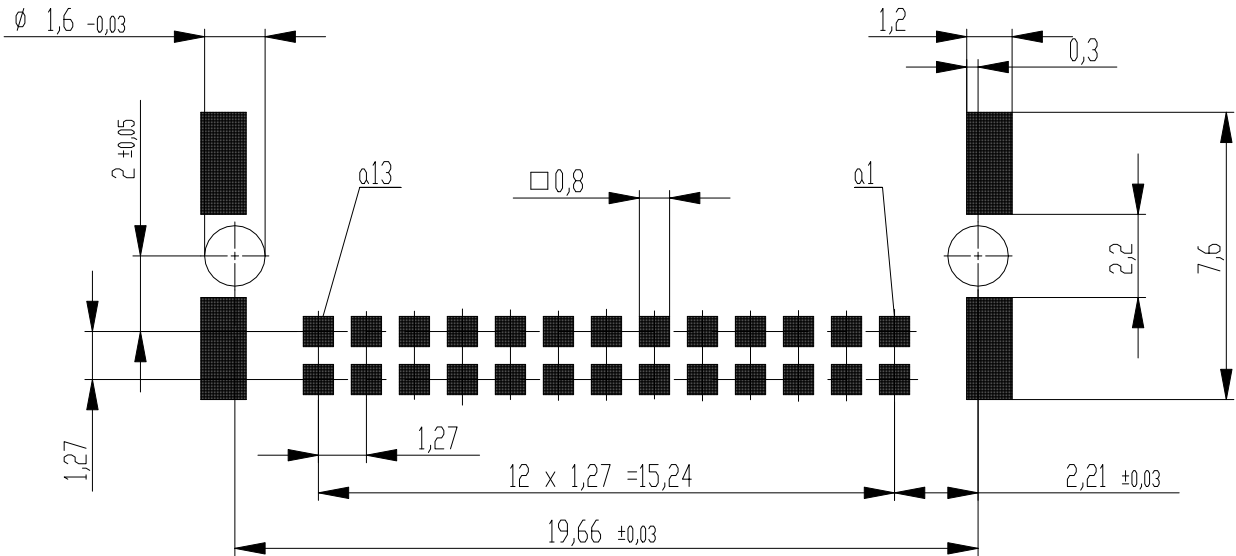
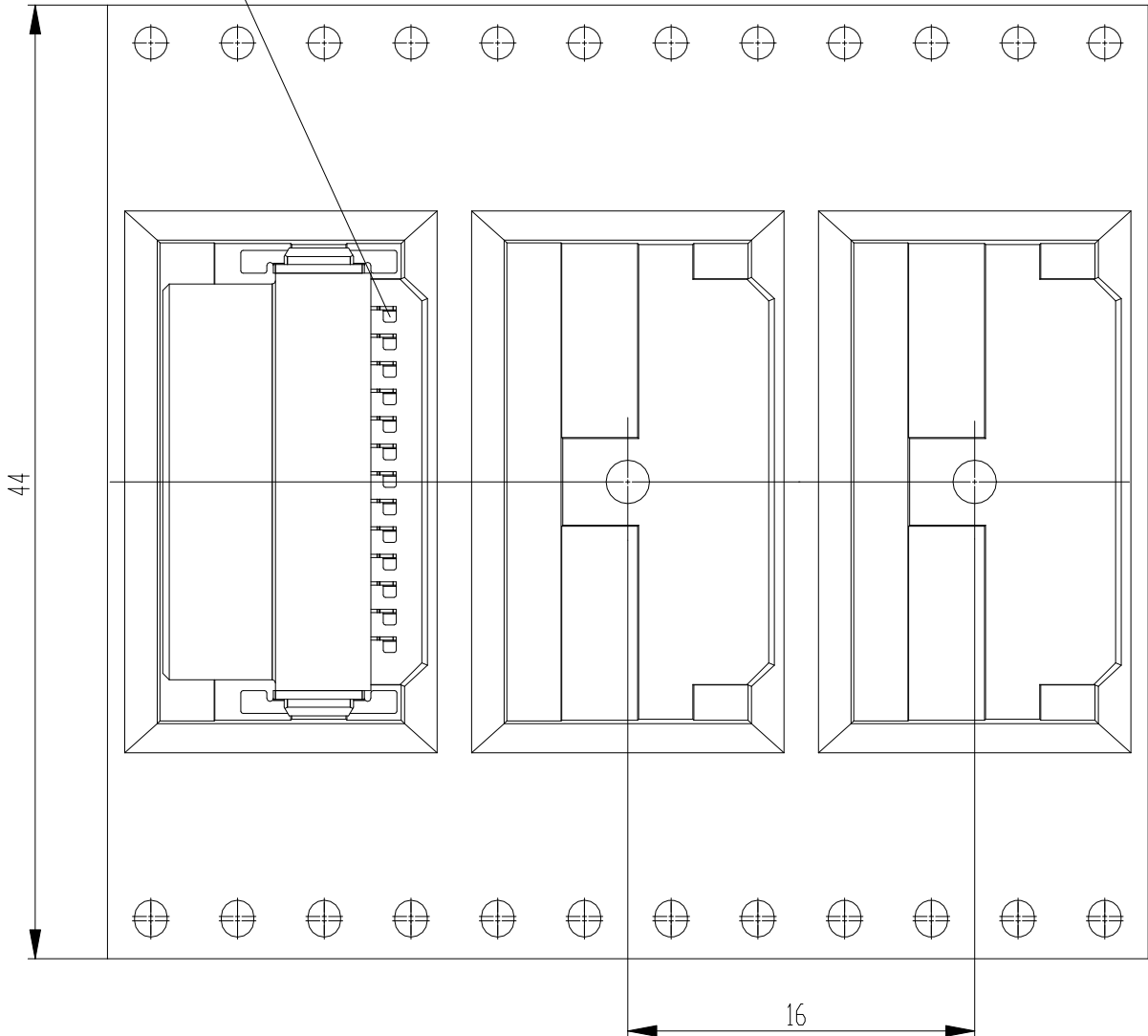


Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
PCB-Layout Proposal for SMT

Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 560 Stück
packaging unit: 560 pcs



Abspulrichtung - reel off direction



Anforderungsstufe 1
performance level 1

Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating

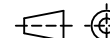
Anschlussbereich verzinkt 4-6 μm
terminal area 4-6 μm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse $\leq 0,1 \text{ mm}$
coplanarity area of termination $\leq 0,1 \text{ mm}$

BA7-03 - Standard Bauhöhe

type7-03 - standard assembly height

Alle deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Erschöpfung der
Handlung bei Änderungen von den englischen Original gilt das
regionaler Änderungen von den englischen Original gilt das
and any deviation the English version shall prevail.
In case of any deviation the English version shall prevail.
Alle deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Erschöpfung der
Handlung bei Änderungen von den englischen Original gilt das
regionaler Änderungen von den englischen Original gilt das
and any deviation the English version shall prevail.
In case of any deviation the English version shall prevail.

Dimension no.				Tolerances Din. for Information ISO 8015		 All Dimensions in mm		Scale Material 5:1	
Customer drawing: THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		ERNI-Federl. SMC-Q 26-SMD-BA7-03 Female SMC-Q 26-SMD-type7-03			
g		25.05.2021				©=154741-E			I
Index		Date				Class SMCQ			A2